

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

에이티세미콘(089530)

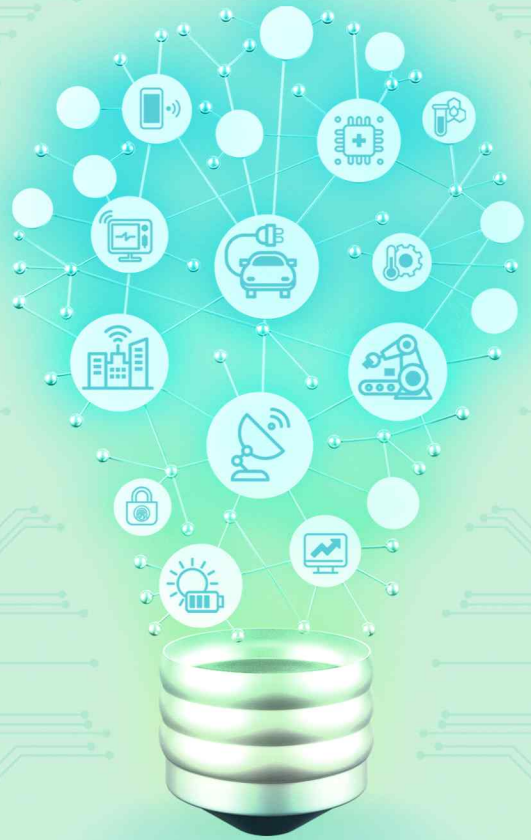
반도체/반도체장비

요약

기업현황

재무분석

주요 변동사항 및 ESG 현황



작성기관

NICE평가정보(주)

작성자

유가영 전문연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술 신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미 게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)으로 연락주시기 바랍니다.



한국IR협회



에이티세미콘(089530)

반도체 패키징 및 테스트 전문기업

기업정보(2021/01/01 기준)	
대표자	김형준
설립일자	2001년 07월 27일
상장일자	2011년 11월 11일
기업규모	중견기업
업종분류	전자집적회로 제조업
주요제품	반도체 패키징 전자집적회로 제조, 반도체 테스트

시세정보(2021/08/30 기준)	
현재가(원)	2,775
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	415
발행주식수	14,962,842
52주 최고가(원)	10,554
52주 최저가(원)	1945
외국인지분율	0.86%
주요주주	김형준

■ 종합 반도체 후공정 선도기업

에이티세미콘(이하 동사)은 반도체 패키징 및 테스트 전문기업으로, Wafer Probe Test, 어셈블리, 최종 테스트까지 신속하고 경쟁력 있는 Total Solution을 제공하고 있다. 진천에 어셈블리 전용라인, 이천에 Memory Test 전용라인, SoC 및 MCP Test 전용라인을 구축했으며, 국내외 종합 반도체 업체들과 팹리스 업체 등 약 70여 고객들에게 솔루션을 제공하고 있다. 주요제품은 MCP, CI-MCP, e-NAND, BOC, SIP 등이 있으며, 급변하는 시장 상황에서 고객의 다양한 요청에 대응할 수 있도록 지속적인 투자와 연구개발 활동을 진행하고 있다.

■ 코로나19 확산세와 장기화에도 반도체 산업 긍정적 예상

코로나19의 글로벌 확산과 장기화에 따라 각국의 봉쇄조치 등으로 인해 여러 산업이 큰 피해를 받았으나 반도체 산업은 수혜를 입은 산업 중 하나이다. 코로나19 상황에서 디지털화 및 클라우드화 추세가 빨라졌으며, 재택근무, 원격교육의 확산과 집에서 즐길 수 있는 미디어, 엔터테인먼트 수요 증가로 반도체 시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

■ 신성장동력 마련을 위한 사업영역 확대

동사는 종속회사를 통해 방위산업, 바이오산업으로 사업영역을 확대할 예정이다. 나노 기술 업체인 에이펙셀과 합작사 에이펙셀생명과학을 설립하여 의료용 진단사업, 의료용 백신 및 치료제사업, 방역사업, 백신류 및 진단제 개발 등으로 바이오산업에 진출한다. 또한, 방산용 드론 전문기업인 에이디이 지분 인수를 위한 협약을 체결했으며, 사우디아라비아 정부가 추진하는 ‘사우디 비전 2030 프로젝트’의 드론 사업을 추진할 예정이다. 이처럼 동사는 중장기 사업 강화 전략을 수립해 경쟁력을 확보해나가고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	1,196	15.8	68	5.7	37	3.1	7.7	3.8	171.6	451	5,204	9.9	0.9
2019	1,281	7.1	24	1.9	(95)	(7.4)	(26.5)	(7.5)	297.9	(1,091)	4,439	(5.3)	1.3
2020	1,295	1.1	(94)	(7.3)	(310)	(23.9)	(80.6)	(19.3)	333.9	(2,570)	3,015	(2.6)	2.2

기업경쟁력

반도체 후공정 선도기업

■ 반도체 패키징 사업

- 패키지별 제조 설비 및 공정 보유, 공정 및 설비기술 대응능력, 납기 대응능력, 품질관리 능력 보유
- 다양한 고객군 확보, 매출 성장세 시현

■ 반도체 테스트 사업

- Wafer의 두께를 얇게 만드는 백 그라인드 공정에서부터 패키징 및 테스트 단계에 이르기까지 후공정 관련 Total Solution 구축

핵심경쟁력

■ 고객 맞춤 서비스 지원

- 제품의 단가에 따라 장비군이 모두 구성되어 있어 고객의 요구에 맞춰 원가적인 측면 지원

■ 목표제품에 대한 기술력 보유 및 지원

- 숙련된 엔지니어 보유, 개발부터 양산까지 전 과정 엔지니어 지원을 통해 제품의 안정성 확보

■ 인프라 구축

- 생산효율화 시스템(MES)을 구축하여 실시간 모니터링, 납기의 신속성 확보 및 고객의 만족도 충족

핵심기술 및 취급 품목

핵심기술

■ Total Solution


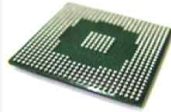
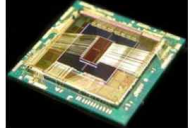
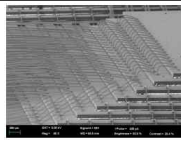


- 백 그라인드 공정부터 패키징 및 테스트 단계까지 일괄생산 체계 구축

■ 반도체 후공정

- 웨이퍼 절단 → 칩 접착 → 배선 → 봉지성형 도금 및 패키징 절단 → 테스트 및 포장

- 메모리와 시스템반도체 등 반도체 전 분야의 패키징 및 테스트 서비스 제공 가능

주력 제품

		
BOC	FBGA	SIP
		
MCP	QFP	TSOP

ESG 현황

Environment

항목	현황
환경 정보 공개	田
환경 경영 조직 설치	田
환경 교육 수준	田
환경 성과 평가체계 구축	田
온실가스 배출	田
에너지, 용수 사용	田
신재생 에너지	田

田 : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

Social

항목	현황
인권보호 정책 보유	田
여성/기간제 근로자 근무	田
협력사 지원 프로그램	田
공정거래/반부패 프로그램	田
소비자 안전 관련 인증	田
정보보호 안전 관련 인증	田
사회공헌 프로그램	田

田 : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

Governance

항목	현황
주주의결권 행사 지원제도	田
중장기 배당정책 보유	田
이사회 내 사외이사 보유	田
대표·이사회 독립성	田
감사위원회 운영	田
감사 업무 교육 실시	田
지배구조 정보 공개	田

田 : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

- 동사는 홈페이지에 환경 관련 정보를 공개하고 내부환경관리 조직을 운영하고 있으며 환경 성과 평가체계를 구축하였음.
- 인권보호 정책 보유, 여성/기간제 근로자 근무 등을 진행하고 있으나, 협력사 지원 프로그램, 사회공헌 프로그램 등은 운영하지 않고, 소비자 안전, 정보보호 안전 관련 인증이 미흡함.
- 이사회 내 사외이사 비중이 약 30%로, 이사회 독립성을 확보하고 있으나, 감사위원회는 운영하지 않음.

* 본 ESG현황은 나이스평가정보사가 분석대상 기업으로 입수한 정보를 요약 정리한 것으로, 분석 시점 및 기업의 참여도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

I. 기업현황

반도체 전문 후공정 선도기업

동사는 설립 이래 반도체 패키징 및 테스트 사업을 영위하고 있으며, Total Solution을 구축하여 반도체 후공정 산업을 선도하고 있다.

■ 개요 및 사업 현황

동사는 2001년 하이닉스(현 SK하이닉스)의 테스트 연구실에서 분사하여 2011년 코스닥 시장에 상장한 기업으로, 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있다. 경기도 이천시에 본사를 두고 있으며, 최대주주인 김형준 대표이사가 경영총괄을 맡고 있다. 동사의 종속회사로는 ATsemicon Japan, ATsemicon Cambodia, 한류티브이 서울, 에이티에이엠씨, 에이치젠바이오, 에이팩셀생명과학 등이 있는 것으로 확인된다.

주 사업인 반도체 패키징 및 테스트는 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업이며, 반도체 패키징 공정은 반도체 칩이 외부와 신호를 주고받을 수 있도록 길을 만들어주고 다양한 외부환경으로부터 안전하게 보호받는 형태로 만드는 공정이다. 동사는 반도체 후공정 Turn-Key 서비스를 제공하고 있으며, Wafer Probe Test를 시작으로 어셈블리, 최종 테스트까지 신속하고 경쟁력 있는 솔루션을 제공하고 있다.

■ 보유기술 및 주요 제품 현황

반도체 후공정에 참여하는 업체들은 패키징 기술, 테스트 기술, 양산능력, 고품질, 안정화, 대규모 설비 등에 기반을 확보하는 것이 필수적이다. 동사는 2020년 기업부설연구소를 설립하였으며, 제품 생산을 위한 공장 및 설비 확장, 양산 장비, 테스트 수량 등 외부에서 실시간 모니터링이 가능하도록 생산효율화시스템(MES)을 구축하여 MCP(Multi Chip Package), e-NAND, SIP(System In Package), FCBGA(Flip Chip Ball Grid Array) 등의 제품을 생산하고 있다. 진천사업장과 이천사업장을 두고 있으며, 진천사업장은 어셈블리 전용설비, 이천사업장은 메모리 테스트 전용설비/Soc 및 MCP 테스트 전용설비를 구축하였다.

표 1. 동사의 사업장

이천사업장(테스트)	진천사업장(패키징)
	

*출처: 동사 홈페이지(2021)

2021년 반기보고서 기준 주요 품목인 반도체 패키징 및 테스트 공정으로 인한 제품 매출이 83%, 임가공은 14%의 비중을 차지하는 것으로 확인된다. 당사는 국내, 해외 대형 IDM 업체부터 중소형업체까지 다양한 고객군을 확보하고 있으며, 테스트 능력에 기반한 품질관리 능력과 중고 장비 도입을 통한 고정비용 절감 및 원가경쟁력 확보, 수요처의 Needs에 기반한 적극적인 납기 대응능력과 주요 매출처와 쌓아온 신뢰관계를 기반으로 지속적인 매출을 실현하고 있다.

표 2. 동사의 주요 제품군(2021년)

구분	구체적 용도	매출액(백만 원)	비율(%)
반도체 패키지 및 테스트 제품	반도체 칩을 Substrate에 탑재하여 전기적으로 연결하여 반도체로서의 기능성 부여	23,764	83
반도체 패키지 공정 및 테스트 임가공	Wafer 및 Package 상태의 반도체의 양품/불량 판정 Program 개발 / Yield 및 불량 분석 / TAT reduction 등	3,887	14
기타	기타	625	2
합계		28,466	100

*출처: 반기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 연구개발 이력

동사는 한국산업기술진흥협회로부터 인정받은 기업부설연구소를 2020년 02월에 설립하여 운영하고 있다. 2021년 반기보고서 기준 20명의 연구개발 인력을 보유하고 있으며, 연구개발비는 낮은 수준이나 매출 증대 및 생산성 증가, 기술 확보 등의 목적으로 2000년부터 2021년까지 115건의 연구개발 과제를 진행하였다.

표 3. 주요 연구개발 실적

개발 기간	연구과제명	기대효과
2020.07~2020.09	3D Nand(96Layer) Wafer 적용 uMCP 10Stack PKG 개발	기술확보 및 매출증대
2015.01~2015.04	Frame Rate Converter 用 256FBGA (Logic + I. Sub. + DRAM : MCP) PKG 개발	매출증대
2010.03~2010.05	High Speed Octal Test 개발	매출증대
2005.04~2006.03	BOC Package Stack 기술 개발	매출증대
2000.08~2000.10	DRAM Memory 54/66/86-TSOP2-400 LOC Package Process 개발	생산성 증가

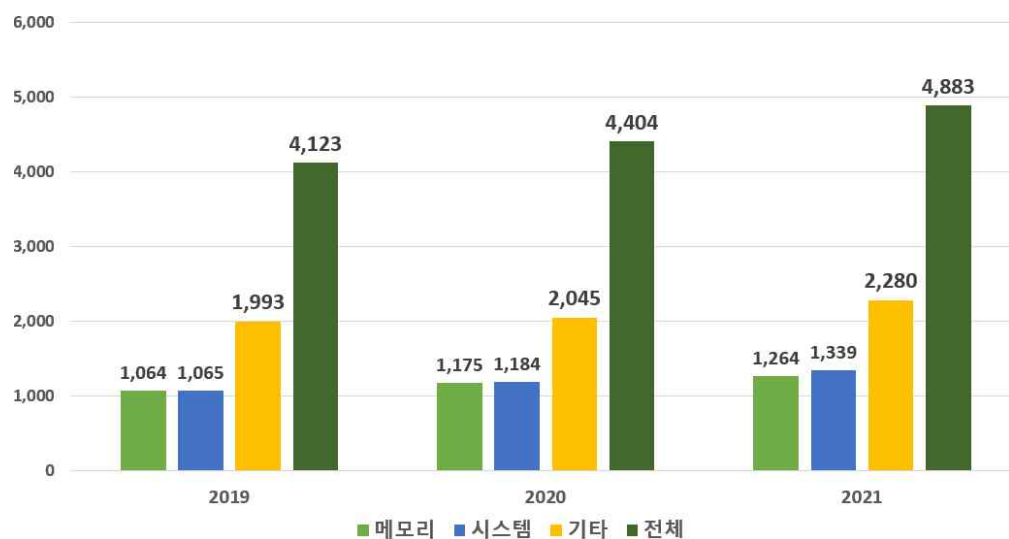
*출처: 반기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 시장 현황 및 경쟁사 현황

세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면 세계 반도체 전체 시장규모는 2020년 4,404억 달러에서 2021년 4,883억 달러로 성장할 것으로 예측하고 있다. 2020년 기준으로 전 세계 반도체 산업에서 메모리 반도체는 1,175억 달러로 33%, 로직 반도체는 1,184억 달러로 33%를 차지하고 있다. 그 외에는 마이크로, 아날로그, 센서, 옵토, 디스크리트 순으로 점유율을 차지하고 있다.

그림 1. 세계 반도체 시장규모

(단위: 억 달러)



*출처: WSTS(2021), NICE평가정보(주) 재구성

반도체 패키징 사업을 영위하고 있는 국내 주요 경쟁사들의 매출실적, 생산량과 제품가격이 모두 반영되는 매출액을 기준으로 국내시장 규모 및 시장점유율을 추정한 결과 Amkor Korea 59.04%, ASE Korea 11.92%, SFA반도체 12.20%, 시그네틱스 4.52%, 하나마이크론 6.99%, 동사 2.85%, 원팩 2.47% 순이며, 동사가 6위를 차지했다.

■ 기술사업 분석

반도체 공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분하며, 웨이퍼를 절단하여 개별 조립, 테스트 및 포장하는 과정을 후공정이라고 하고 후공정 전반을 일반적으로 패키징이라 지칭한다. 설립 초기 DRAM용 BOC 패키지 개발을 시작으로, 현재는 High-End 반도체 패키징 기술개발 및 생산역량 강화에 집중하고 있으며, 급변하는 시장 상황에서 고객의 다양한 요청에 대응할 수 있는 폭넓은 패키지 제품을 제공하고 있다. 현재 웨이퍼의 두께를 얇게 만드는 백그라운드 공정에서부터 패키징 및 테스트 단계에 이르기까지 후공정 관련 Total Solution을 제공할 수 있는 일괄 생산체계를 구축하였고, 메모리와 시스템반도체 등 반도체 전 분야의 패키징 및 테스트 서비스를 제공할 수 있는 기술력을 보유하고 있다.

프. 재무 분석

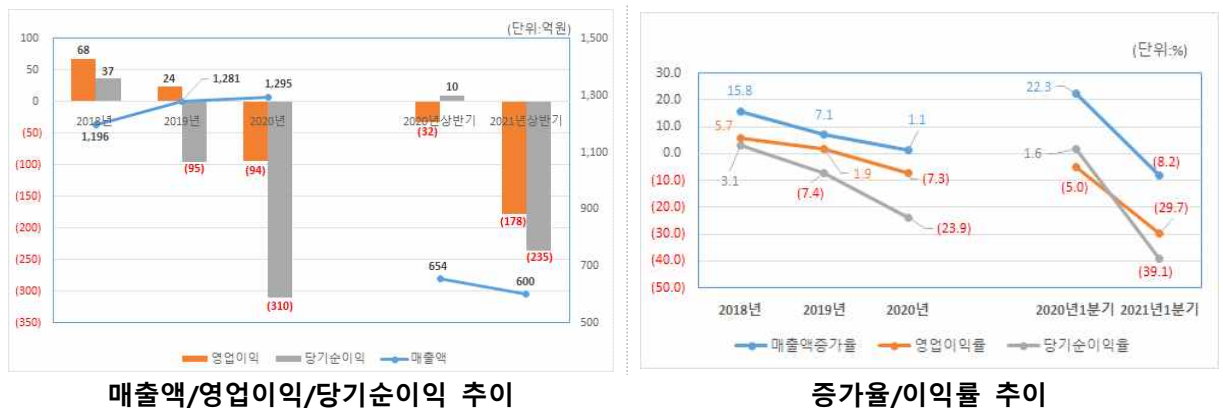
전방산업 업황 회복에 따른 매출 소폭 증가에도 영업이익 적자 전환

동사는 2020년 연결기준 전방 반도체 사업의 업황 회복으로 매출이 소폭 증가하였으나, 원재료비 증가 등으로 영업이익이 적자 전환되는 등 전반적인 수익성은 악화되었다. 향후 글로벌 업체 발굴 및 제품 다변화 전략 패키징, 테스트가 모두 가능한 Turn-Key 솔루션 구축 전략을 바탕으로 고부가가치 제품의 판매 증대, 사업다각화 등을 통해 외형 성장할 것으로 전망된다. 다만, 종합 반도체 회사들의 생산계획 및 수주에 의존적 사업구조를 지니고 있어 전방산업 경기 동향에 따라 영향을 크게 받을 것으로 보인다.

2020년 임가공수입 등의 증대로 매출 증가

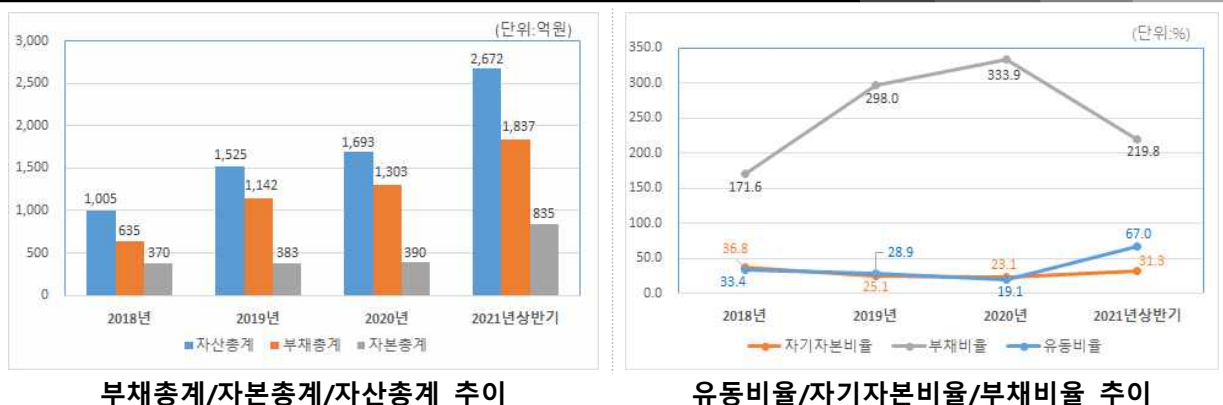
동사의 주요 사업부문은 반도체 패키징 부문과 반도체 테스트 부문으로 구성된다. 2020년 연결기준 제품매출 비중은 81%이며, 임가공매출 비중은 16%이다. 매출 비중이 큰 제품매출 실적은 전년 수준으로 정체이나, 임가공매출 실적이 전년 대비 9.5% 확대됨에 따라 당기 총매출이 소폭 증가하였다.

그림 2. 동사 연간 및 상반기 요약 포괄손익계산서 분석 (연결기준)



*출처: 동사 사업보고서(2020), 상반기보고서(2021)

그림 3. 동사 연간 및 상반기 요약 재무상태표 분석 (연결기준)



*출처: 동사 사업보고서(2020), 상반기보고서(2021)



■ 매출 증가에도 불구하고, 수익성 악화

동사는 2020년 결산기준 전방산업의 업황 회복 및 내수 임가공, 제품 수주 물량 확대로 전년 대비 1.1% 증가한 1,295억 원의 매출을 시현하였다.

최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2018년 1,196억 원(+15.8% YoY), 2019년 1,281억 원(+7.1% YoY)에서 2020년 1,295억 원(+1.1% YoY)을 기록하며 매출 증가세를 나타내었으나, 증가폭이 크게 둔화되고 있는 추세이다.

수익성 측면에서는 원재료비 증가 등에 따른 원가 부담 확대와 인건비, 대손상각비 등의 증가로 판관비 부담 또한 가중되어 매출액영업이익률이 2019년 1.9%, 2020년 -7.3%를 기록하며 영업이익 적자 전환한 가운데, 파생상품평가손실 발생, 이자비용 증가 및 손상차손 인식 등으로 영업외비용이 확대되어 매출액순이익률 적자폭이 2019년 -7.4% 대비 심화된 2020년 -23.9%를 기록하였다.

재무안정성 측면에서는 적자 시현에도 전환사채 전환으로 자기자본이 확충되었으나, 미지급금 등의 증가에 따른 부채규모 확대로 재무안정성 지표가 전년 대비 저하된 자기자본비율 23.1%, 부채비율 333.9%를 기록하였고, 여전히 높은 차입부채 부담(차입금의존도 49.0%) 등으로 미흡한 재무구조를 지속하였다. 또한, 유동비율이 19.1%로 최근 3년간 하락추세를 나타내는 등 유동성 부담 또한 높을 것으로 판단된다.

■ 2021년 상반기 전년 동기대비 매출 감소 및 영업이익 적자 심화

2021년 상반기 기준 코로나19 장기화로 인한 해외 매출 부진 등으로 전년 동기대비 8.2% 감소한 600억 원의 매출을 시현하였다. 수익성 측면에서는 매출액을 상회하는 높은 원가 부담과 판관비 증가로 매출액영업이익률 적자폭이 전년 동기대비 대폭 확대된 -29.7%를 기록하였고, 파생상품평가이익 감소와 대규모 지분법손실 발생 등으로 매출액순이익률이 -39.1%를 기록하며 순이익 적자 시현하였다.

2021년 상반기 중 전환사채의 전환권행사에 따라 자본금 83억 원 증가하였고 10:1 무상감자 실시로 자본금 641억 원 감소하였으며 전환사채 410억 원 추가발행 하였다.

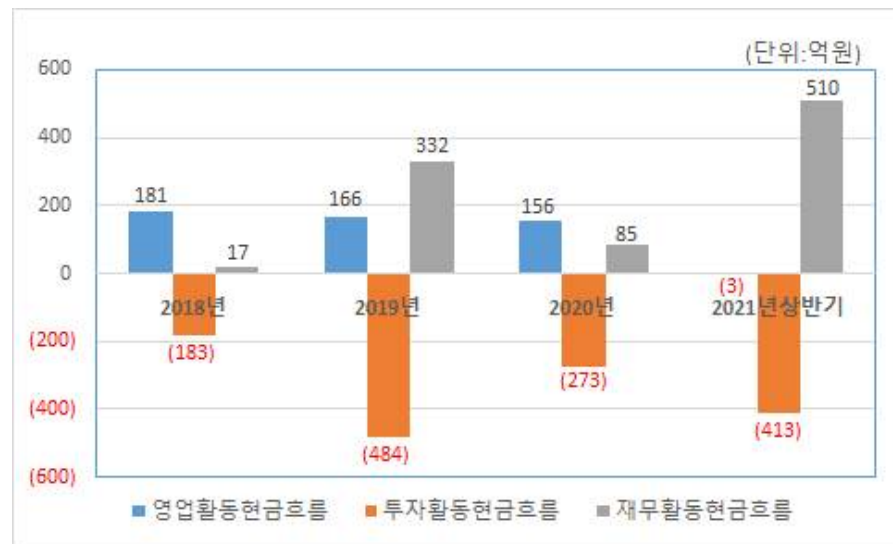
주요 재무안정성 지표로 부채비율 219.8%, 자기자본비율 31.3%를 기록하는 등 높은 부채 부담의 미흡한 재무구조를 지속하였다.

■ 정(+)의 영업활동현금흐름 유지하였으나, 투자활동에 기보유현금 투입

2020년 순손실 발생에도 불구하고, 매출채권 감소 등으로 영업활동현금흐름이 최근 3년간 정(+)의 상태를 유지하였으며, 영업창출현금 156억 원과 차입금 조달 등의 재무활동을 통해 유입된 85억 원을 비롯한 기보유현금을 통해 금융자산 및 유형자산 취득 등 투자활동 273억 원에 충당하였다.



그림 4. 동사 현금흐름의 변화 (연결기준)



*출처: 동사 사업보고서(2020), 상반기보고서(2021)

Ⅲ. 주요 변동사항 및 ESG 현황

지속적인 설비 투자와 사업 확대를 통한 성장 기대

반도체 패키징 사업을 넘어 신사업을 추진하고 있으며, 고부가가치 반도체 제품 수주 증가와 제3공장 증설 효과로 본격적인 성장을 준비하고 있다. 또한, 환경 관련 인증, 기간제/여성 근로자 채용을 통해 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있다.

■ 주요 사업 이슈

동사는 다양한 분야에서의 업무 협약을 통해 신성장동력을 마련하고 있다. 2020년 하반기 바이오 사업추가에 이어 2021년 상반기 드론 분야 방위산업에 진출했다. 바이오 사업은 에이펙셀과 합작하여 에이펙셀생명과학을 설립했다. 사업 목적에는 의료용 진단사업, 의료용 백신 및 치료제사업, 방역사업, 백신류 및 진단제 개발 및 판매업 등이 추가됐으며, 신사업으로 세포치료사업, 재생의료 관련업, 제대혈 및 줄기세포 분야를 낙점했다.

드론 방위산업은 국내 드론 전문기업인 에이디이의 지분 인수를 위한 협약을 체결하였다. 에이디이는 드론을 전문적으로 개발하는 회사로 미국 드론 전문 방산기업인 ARA와 기술 제휴를 통해 2015년부터 최고 수준의 고정익 드론, 회전익 드론, 안티드론 솔루션 등을 개발하고 있다. 에이디이는 2020년 사우디아라비아 정부로부터 ‘사우디 비전 2030 프로젝트’의 방위산업 분야 사업자로 선정됐고, 동사는 에이디이의 지분 인수를 완료하여 프로젝트의 전용 실시권 및 전문 인력을 제공받아 사업을 추진할 계획이다. 또한, 사우디아라비아 정부가 85%, 동사가 15%의 지분을 투자하여 조인트벤처를 설립하고 조인트벤처가 투자해 사우디아라비아 현지에서 안티드론 개발 및 생산용 공장을 설립할 계획인 것으로 확인되었다.

사업 다각화를 통해 반도체 후공정 사업에 대한 매출 의존도를 줄이고 신규 고객사 발굴을 통해 시장경쟁력을 강화하고 있다.

■ 기술에 대한 향후 전망

반도체 후공정 산업은 장치 산업에 속하며 고가의 장비를 보유해야 양산할 수 있다. 다양한 제품 및 공정발달로 다양한 장비군을 형성하는 것이 가장 중요한데 이와 관련하여 동사는 2020년 충북 진천 제3공장을 증설했다. 반도체 패키징 생산능력 확대와 신규 제품 수주에 적극 대응하기 위한 것으로 102억 원을 투자해 반도체 패키징 및 테스트 신규 장비를 구축하고 있다.

또한, 주요 제품군이 메모리 중심에서 비메모리 반도체로, 전통적인 1세대 패키지인 DIP, SOP 제품군에서 차세대 고부가가치 패키지인 BGA, QFP로 확대되는 등 사업 구조의 질적인 변화를 통해 주력 시장의 성장기회를 향유 할 수 있는 다양한 확장 및 성장의 축을 확보하였다.

■ ESG 활동 현황

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻한다. ESG 평가는 기업엔 지속 가능 경영의 동기를 유발하고 투자자에게는 사회적 책임 투자에 대한 접근성을 제고하는 지표로 활용할 수 있다.

동사의 환경방침은 ISO 14001-2015/KS A 1400-2004 규격에 따른 환경경영시스템을 구축, 실행 및 생산 제품에 대한 고객의 요구와 기대를 충족시키는 데 있다.


표 4. 환경방침 및 환경목표

환경방침	환경목표
환경 친화 원재료 사용, 환경 유해요소 최소화	환경친화적 설계
재활용 및 재사용을 통한 환경오염 물질 사전 예방	용수 사용량 30% 재활용
자원 절약, 에너지 절약을 통한 오염물질 감소	전력 사용량의 20% 절감으로 Co2 발생억제
국내외 환경법규 준수 및 주기적 모니터링	국내외 환경법규 100% 준수
지속적인 환경개선을 통한 고객 감동 실현	-

*출처: 동사 홈페이지(2021), NICE평가정보(주) 재구성

환경경영시스템을 효과적으로 운영하며, 적합성을 유지하기 위하여 대표이사는 환경경영 대리인을 지명하고 책임과 권한을 부여하여 환경업무를 적극적으로 수행할 수 있도록 지원하고 있다.

표 5. 보유 인증 현황

인증명	유효기간	상태
 ISO14001:2015	2020-03-11~2022-07-07	유효

*출처: 한국생산성본부 인증원(2021), NICE평가정보(주) 재구성

동사는 광물 채굴 시 주변 지역의 환경 파괴, 노동 착취 등 인권 유린과 관련한 사회적 문제를 유발하는 광산에서 채굴된 광물을 구매하지 않을 것을 서약했다. 금, 탄탈륨, 텅스텐, 주석의 사용에 있어 CFM(Conflict-Free Minerals) 제품사용에 대한 규정을 준수하고 있으며, ‘DRC Conflict-Free’를 실행하고 있다. ‘DRC Conflict-Free’의 정의는 콩고 민주공화국(DRC) 혹은 DRC 주변 국가(수단, 우간다, 르완다, 부룬디, 탄자니아, 앙골라, 중앙 아프리카)의 무장단체에 지원을 하거나 혜택이 되어서는 안되는 제품을 의미하고 동사는 이 정책을 준수하고 있다. 또한, EICC-GeSI(Electronic Industry Citizenship Coalition-Global e-Sustainability Initiative)가 제공한 리스트에서 광물의 원산지가 어디인지 확인하고 공급업체로부터 규제 지역의 광산으로부터 제품이 공급되고 있지 않은지 공급사에 확인하고 있다.



동사의 2021년 반기보고서에 따르면, 기간제 근로자는 6명, 여성 근로자는 170명이며 총 528명의 임직원이 근무하고 있고 인권보호 정책을 운영하고 있다. 다만, 협력사 지원 프로그램, 공정거래/반부패 프로그램, 소비자 안전 관련 인증, 정보보호 안전 관련 인증, 사회공헌 프로그램 등 사회책임경영에 관한 활동이 확대되어야 할 것으로 사료된다.

표 6. 근로자 근무 현황

사업 부문	성별	기간의 정함이 없는 근로자	기간제 근로자	합계
반도체 사업부	남	358	3	361
	여	170	3	173
합계		528	6	534

*출처: 반기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

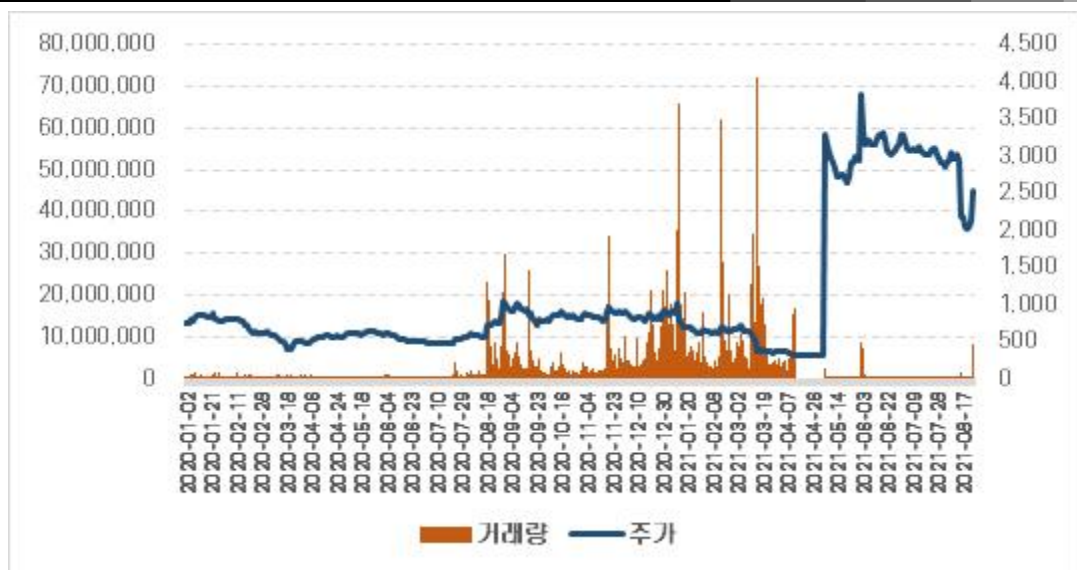
지배구조 부문은 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 2021년 3월 31일 정기주주총회(제20기)를 실시하였다. 금번 주주총회에서 사내이사 1명, 감사 1명이 선임되었으며, 총 7명의 이사 중 2명의 사외이사를 보유하여 이사회 내 사외이사 비중이 약 30%로 이사회 독립성을 확보하고 있다. 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선정하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있다. 또한, 계열회사 지분 표를 공시함으로써 지배구조 정보를 공개하고 있는 것으로 파악된다.



■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
	• 최근 6개월 이내 발간 보고서 없음		

■ 시장정보(주가 및 거래량)



*출처: Kisvalue(2021.08.)